

2019年（平成31年）3月期 第2四半期決算説明会

2018年11月16日

株式会社フジミインコーポレーテッド

決算概要

決算概要 (上期実績)

単位：百万円	18年3月期		19年3月期				
	上期実績	下期実績	上期予想('18/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	上期予想比('18/5)
売上高	17,417	18,371	18,000	19,163	+10.0%	+4.3%	+6.5%
営業利益	2,289	2,583	2,550	2,813	+22.9%	+8.9%	+10.3%
営業利益率	13.1%	14.1%	14.2%	14.7%	-	-	-
経常利益	2,250	2,478	2,600	3,056	+35.8%	+23.4%	+17.6%
経常利益率	12.9%	13.5%	14.4%	15.9%	-	-	-
四半期純利益	1,647	1,364	1,950	2,339	+42.1%	+71.5%	+20.0%
四半期純利益率	9.5%	7.4%	10.8%	12.2%	-	-	-

半導体市場好調により前年同期比増収増益
 四半期純利益は過去最高を更新（'07/3月期以来11期ぶり）

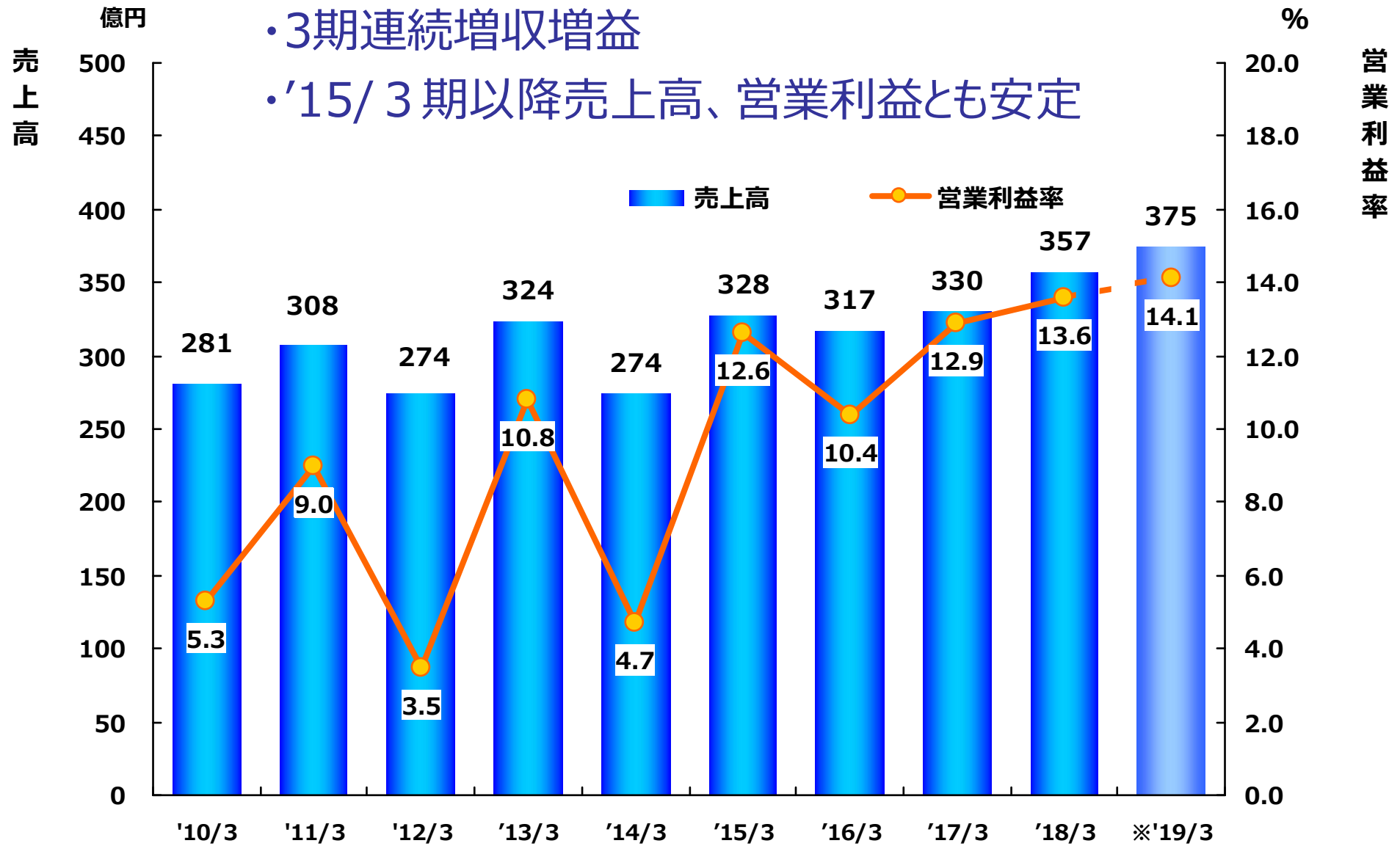
業績予想 (通期予想)

単位：百万円	18年3月期	19年3月期			
	通期実績	期初予想 (‘18/5)	修正予想 (‘18/11)	前期比	期初予想比 (‘18/5)
売上高	35,788	36,500	37,500	+4.8%	+2.7%
営業利益	4,872	5,100	5,300	+8.8%	+3.9%
営業利益率	13.6%	14.0%	14.1%	-	-
経常利益	4,728	5,200	5,600	+18.4%	+7.7%
経常利益率	13.2%	14.2%	14.9%	-	-
当期純利益	3,011	3,900	4,200	+39.5%	+7.7%
当期純利益率	8.4%	10.7%	11.2%	-	-

半導体市場好調を背景に通期の業績予想を上方修正
 下期は期初予想を据え置き

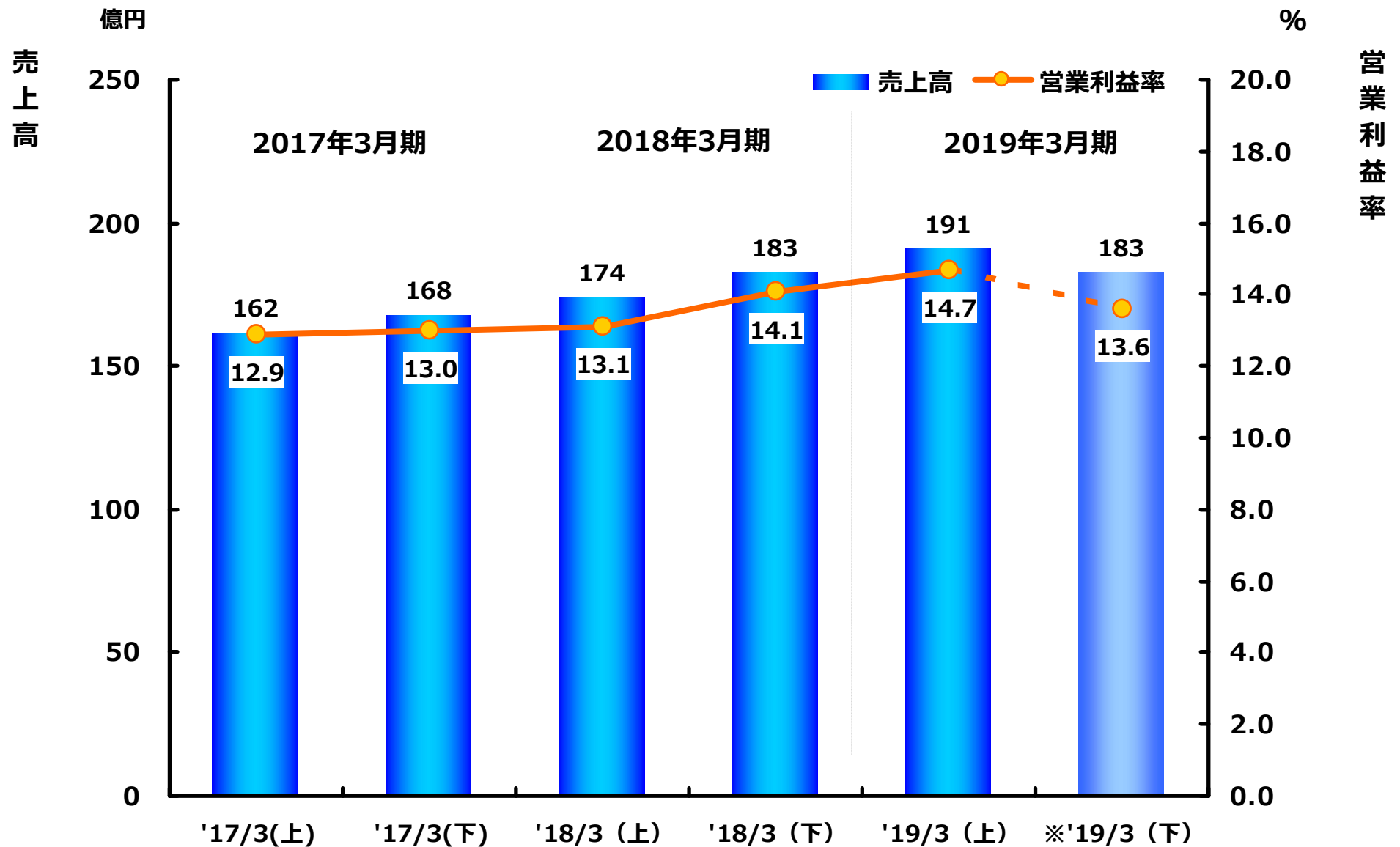
業績推移 (通期)

- ・3期連続増収増益
- ・'15/3期以降売上高、営業利益とも安定



※'19/3は予想値

業績推移 (半期)



用途別売上高

用途別売上高 (上期実績)

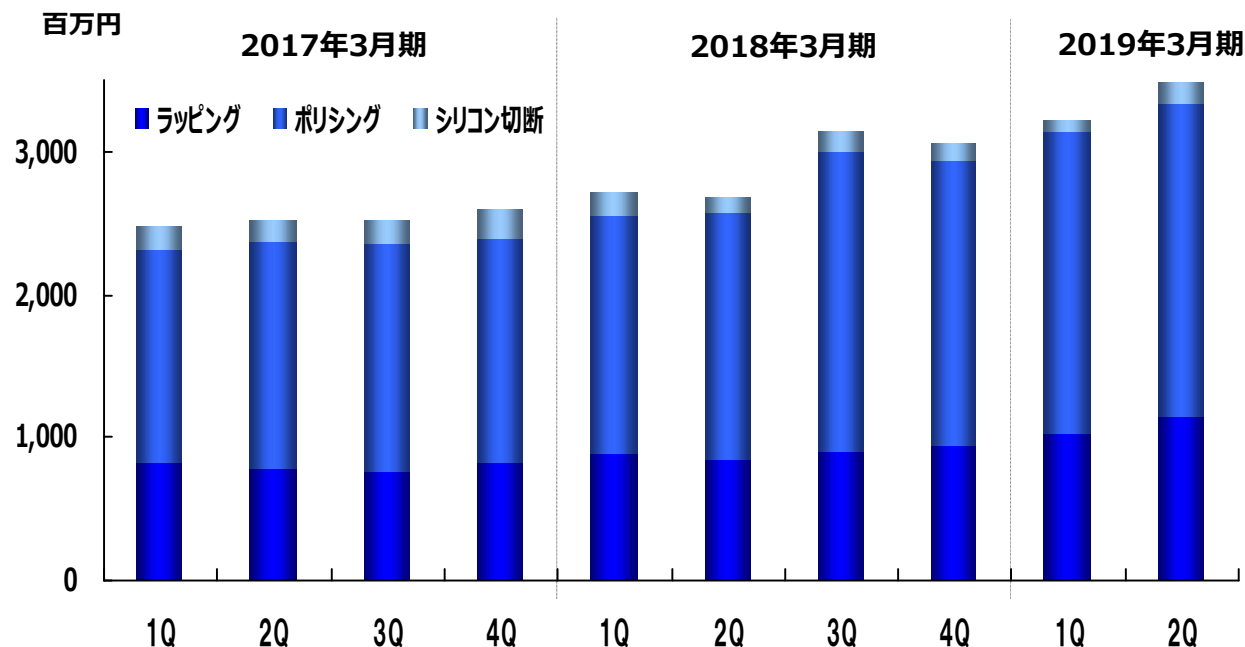
単位：百万円		18年3月期		19年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('18/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('18/5)
シリコンウェハー	ラッピング	1,735	1,852	1,840	2,176	+25.4%	+17.5%	+18.1%
	ポリシング	3,392	4,080	4,070	4,301	+26.8%	+5.4%	+5.7%
	切断	274	260	150	228	△16.9%	△12.5%	+51.8%
	計	5,402	6,193	6,060	6,706	+24.1%	+8.3%	+10.6%
CMP		7,200	7,420	7,460	7,690	+6.8%	+3.6%	+3.1%
ディスク	アルミディスク	1,408	1,285	1,060	1,225	△13.0%	△4.7%	+15.9%
	ガラスディスク	311	231	120	51	△83.6%	△77.9%	△56.8%
	計	1,719	1,517	1,180	1,276	△25.7%	△15.8%	+8.6%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,116	2,128	2,230	2,212	+4.5%	+3.9%	△0.9%
	一般工業用(非研磨材)	890	1,013	970	1,070	+20.2%	+5.6%	+10.9%
	計	3,007	3,142	3,200	3,283	+9.2%	+4.5%	+2.6%
製品売上高		17,329	18,273	17,900	18,957	+9.4%	+3.7%	+5.9%
商品売上高		87	97	100	206	+134.4%	+111.9%	+105.7%
売上高 合計		17,417	18,371	18,000	19,163	+10.0%	+4.3%	+6.5%

シリコンウェハー売上高（上期実績）

「上期」

単位：百万円

		18年3月期		19年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('18/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('18/5)
シリコンウェハー	ラッピング	1,735	1,852	1,840	2,176	+25.4%	+17.5%	+18.1%
	ポリシング	3,392	4,080	4,070	4,301	+26.8%	+5.4%	+5.7%
	切断	274	260	150	228	△16.9%	△12.5%	+51.8%
	計	5,402	6,193	6,060	6,706	+24.1%	+8.3%	+10.6%



・半導体市場好調に加え市場シェア拡大により、ラッピング、ポリシングともに増収

シリコンウェハー売上高（下期予想・通期予想）

「下期」

単位：百万円

		18年3月期		19年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 18/5)	下期修正予想 (' 18/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 (' 18/5)
シリコンウェハー	ラッピング	1,735	1,852	2,176	1,930	2,173	+17.3%	△0.2%	+12.5%
	ポリシング	3,392	4,080	4,301	4,080	4,299	+5.4%	△0.1%	+5.4%
	切断	274	260	228	130	222	△14.9%	△2.7%	+70.3%
	計	5,402	6,193	6,706	6,140	6,694	+8.1%	△0.2%	+9.1%

「通期」

単位：百万円

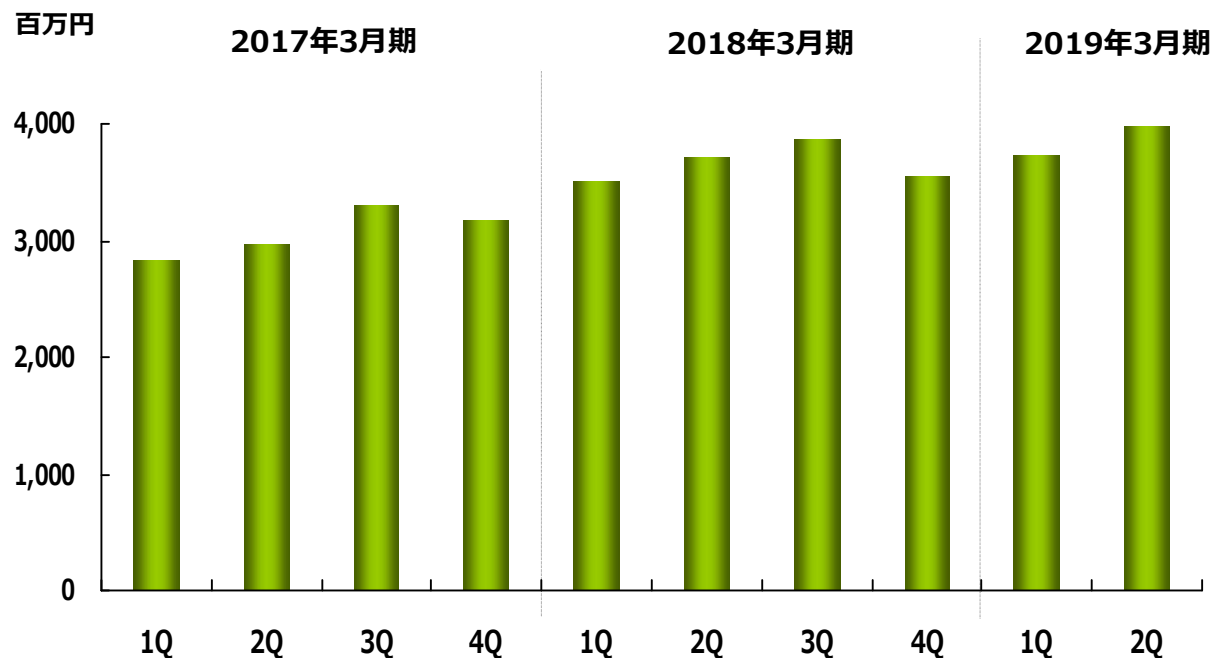
		17年3月期	18年3月期	19年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 (' 18/5)	通期修正予想 (' 18/11)	前期比	期初予想比 (' 18/5)
シリコンウェハー	ラッピング	3,193	3,588	3,770	4,350	+21.2%	+15.3%
	ポリシング	6,245	7,472	8,150	8,600	+15.1%	+5.6%
	切断	655	535	280	450	△15.9%	+60.4%
	計	10,094	11,596	12,200	13,400	+15.6%	+9.8%

CMP売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

	18年3月期		19年3月期				
	上期実績	下期実績	上期予想 ('18/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('18/5)
CMP	7,200	7,420	7,460	7,690	+6.8%	+3.6%	+3.1%



・半導体市場の好調を背景に、ロジック・メモリともに最先端デバイス向け製品が好調で増収

CMP売上高（下期予想・通期予想）

「下期」

単位：百万円

	18年3月期		19年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 18/5)	下期修正予想 (' 18/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 (' 18/5)
CMP	7,200	7,420	7,690	7,540	7,510	+1.2%	△2.4%	△0.4%

「通期」

単位：百万円

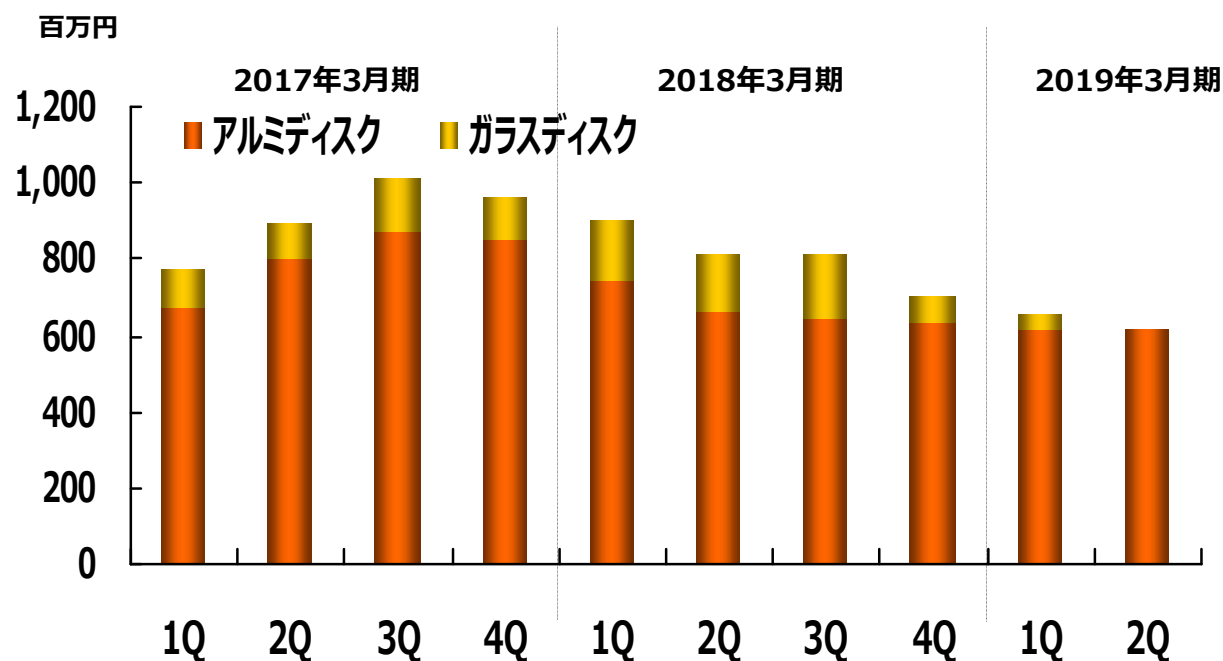
	17年3月期	18年3月期	19年3月期			
	通期実績	通期実績	通期予想 (' 18/5)	通期修正予想 (' 18/11)	前期比	期初予想比 (' 18/5)
CMP	12,270	14,621	15,000	15,200	+4.0%	+1.3%

ディスク売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		18年3月期		19年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('18/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('18/5)
ディスク	アルミディスク	1,408	1,285	1,060	1,225	△13.0%	△4.7%	+15.9%
	ガラスディスク	311	231	120	51	△83.6%	△77.9%	△56.8%
	計	1,719	1,517	1,180	1,276	△25.7%	△15.8%	+8.6%



・アルミディスク向け製品は市場縮小（SSDへの移行）及び顧客のプロセス変更により減収

・ガラスディスク向け製品は顧客のプロセス変更により大幅減収

ディスク売上高（下期予想・通期予想）

「下期」

単位：百万円

		18年3月期		19年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 18/5)	下期修正予想 (' 18/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 (' 18/5)
ディスク	アルミディスク	1,408	1,285	1,225	1,080	1,004	△21.9%	△18.1%	△7.1%
	ガラスディスク	311	231	51	140	18	△92.0%	△63.8%	△86.6%
	計	1,719	1,517	1,276	1,220	1,022	△32.6%	△19.9%	△16.1%

「通期」

単位：百万円

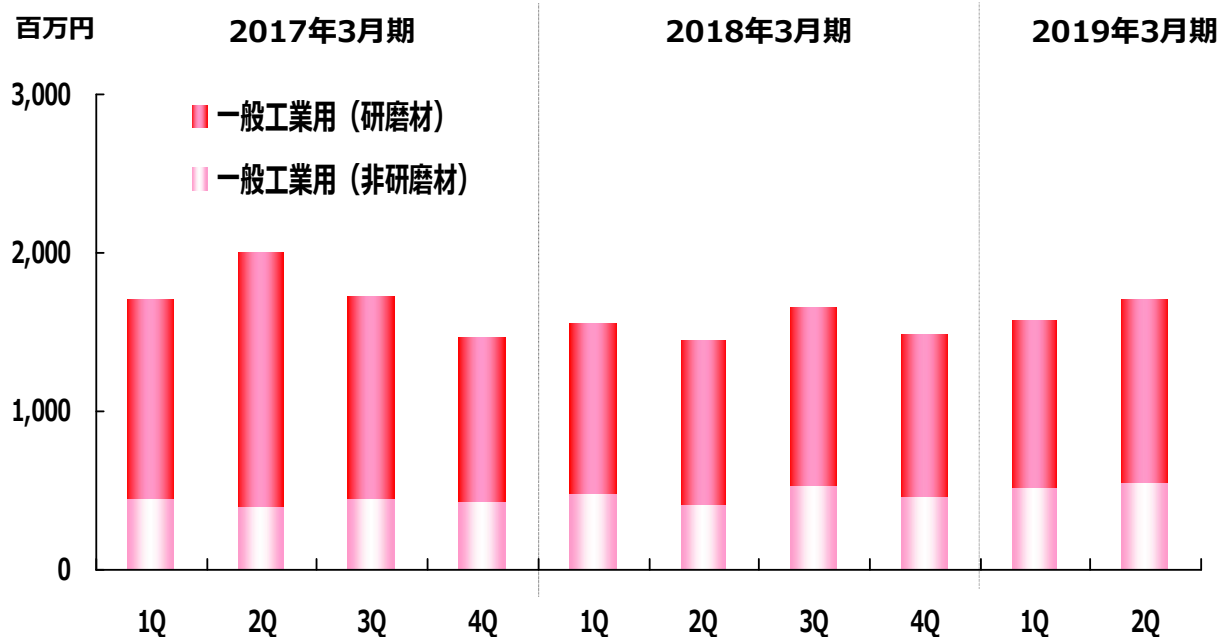
		17年3月期	18年3月期	19年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 (' 18/5)	通期修正予想 (' 18/11)	前期比	期初予想比 (' 18/5)
ディスク	アルミディスク	3,195	2,694	2,140	2,230	△17.2%	+4.3%
	ガラスディスク	454	542	260	70	△87.2%	△72.9%
	計	3,650	3,236	2,400	2,300	△28.9%	△4.0%

機能材・溶射材売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		18年3月期		19年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想('18/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比('18/5)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,116	2,128	2,230	2,212	+4.5%	+3.9%	△0.9%
	一般工業用(非研磨材)	890	1,013	970	1,070	+20.2%	+5.6%	+10.9%
	計	3,007	3,142	3,200	3,283	+9.2%	+4.5%	+2.6%



・一般工業用（研磨材）：
 砥石向け好調により増収

・一般工業用（非研磨材）：
 半導体・液晶製造装置向け溶射材好調により増収

機能材・溶射材売上高（下期予想・通期予想）

「下期」

単位：百万円

		18年3月期		19年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 18/5)	下期修正予想 (' 18/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 (' 18/5)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,116	2,128	2,212	2,370	1,917	△9.9%	△13.3%	△18.9%
	一般工業用(非研磨材)	890	1,013	1,070	1,130	1,050	+3.5%	△2.0%	△7.5%
	計	3,007	3,142	3,283	3,500	2,967	△5.6%	△9.6%	△15.2%

「通期」

単位：百万円

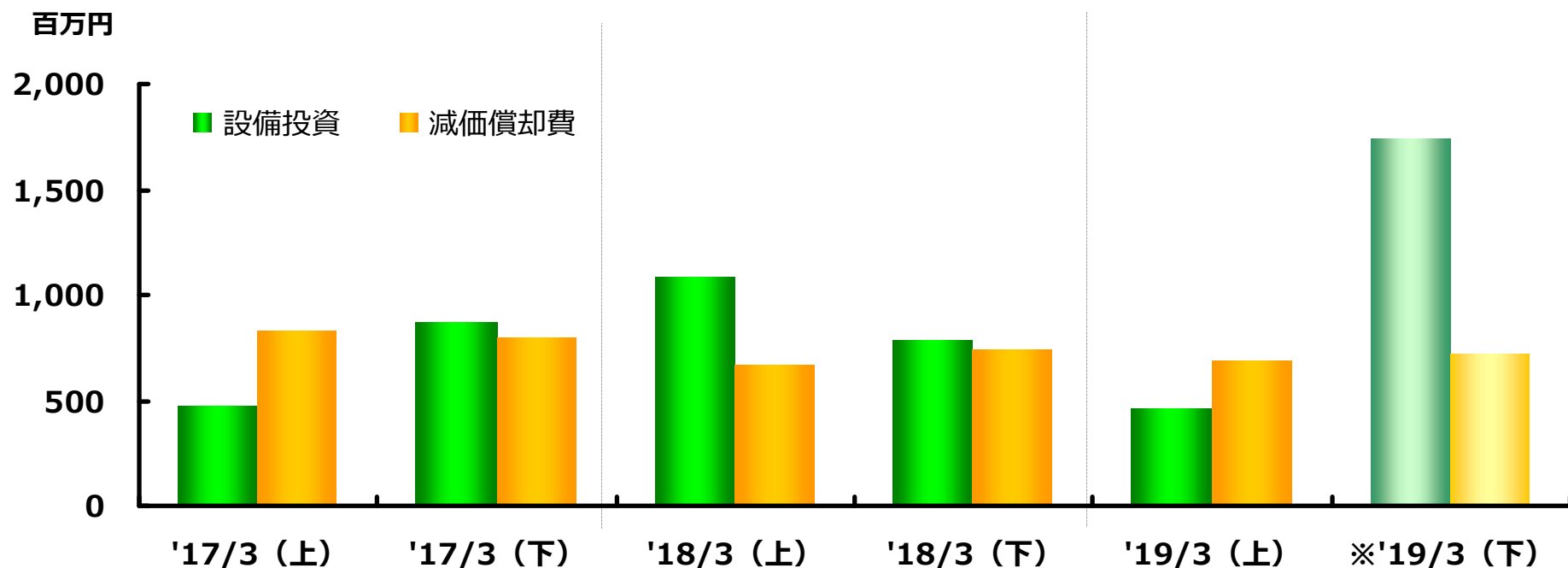
		17年3月期	18年3月期	19年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 (' 18/5)	通期修正予想 (' 18/11)	前期比	期初予想比 (' 18/5)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	5,150	4,244	4,600	4,130	△2.7%	△10.2%
	一般工業用(非研磨材)	1,738	1,904	2,100	2,120	+11.3%	+0.9%
	計	6,889	6,149	6,700	6,250	+1.6%	△6.7%

設備投資額
減価償却費
研究開発費

設備投資額・減価償却費（上期実績・下期計画）

単位：百万円

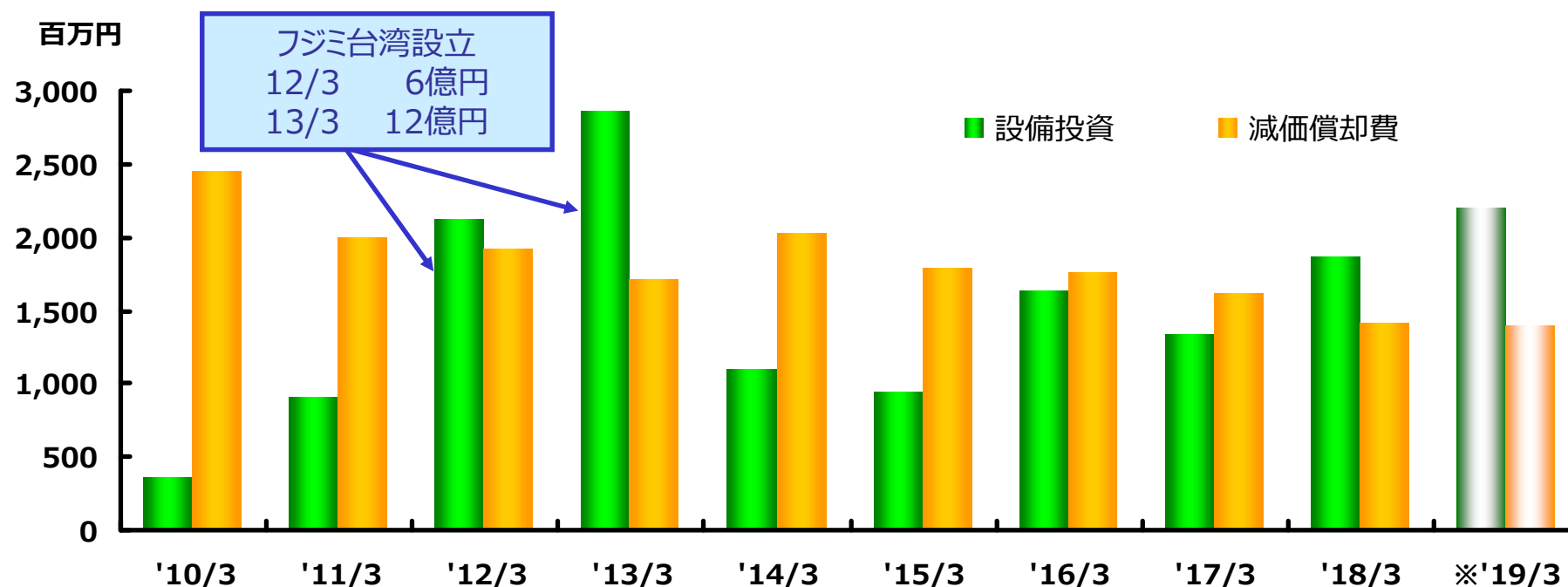
	18年3月期		19年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画 ('18/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	計画比 ('18/5)	下期計画 ('18/5)	下期修正計画 ('18/11)	前年同期比	同年前期比	計画比 ('18/5)
設備投資額	1,083	788	1,400	461	△57.4%	△41.5%	△67.1%	1,000	1,739	+120.5%	+277.2%	+73.9%
減価償却費	665	746	700	684	+2.8%	△8.4%	△2.3%	900	716	△4.1%	+4.7%	△20.4%



設備投資額・減価償却費 (通期実績・通期計画)

単位：百万円

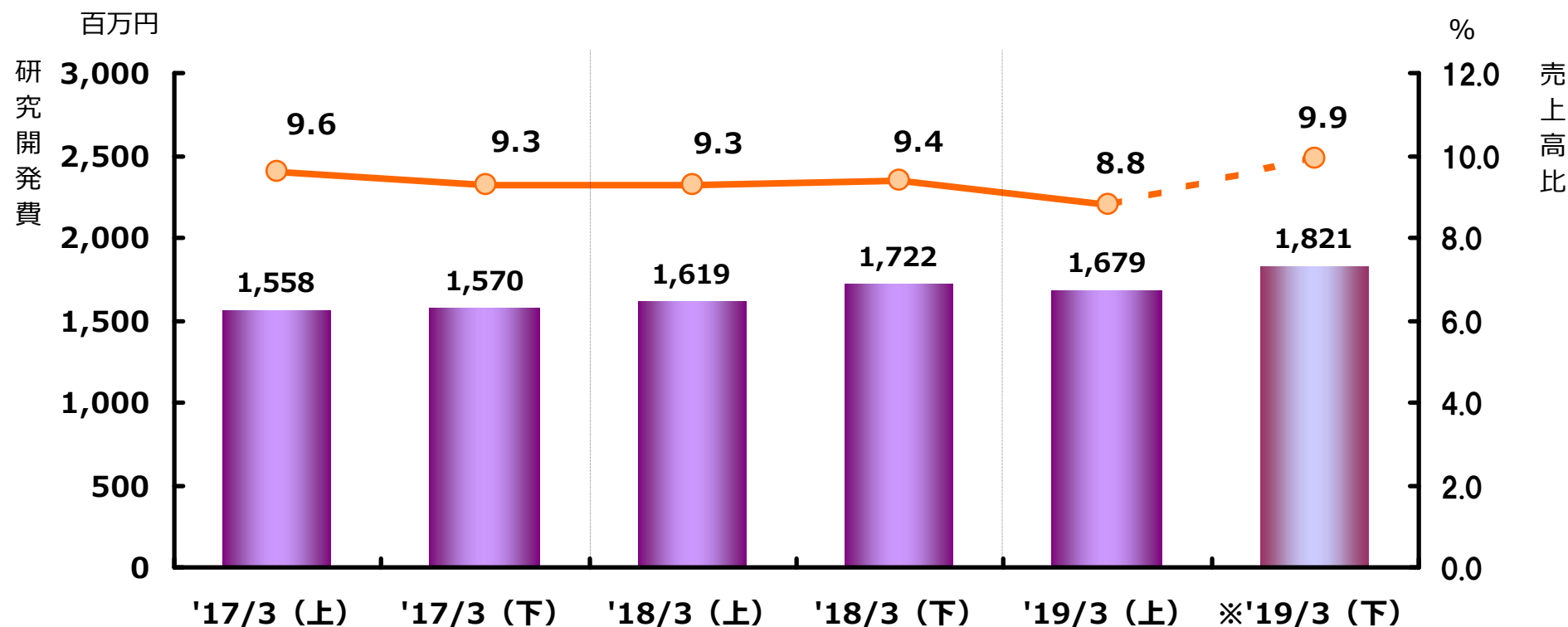
	18年3月期	19年3月期			
	通期実績	通期計画 ('18/5)	通期修正計画 ('18/11)	前期比	期初計画比 ('18/5)
設備投資	1,871	2,400	2,200	+17.6%	△8.3%
減価償却費	1,411	1,600	1,400	△0.8%	△12.5%



研究開発費／売上高比（上期実績・下期計画）

単位：百万円

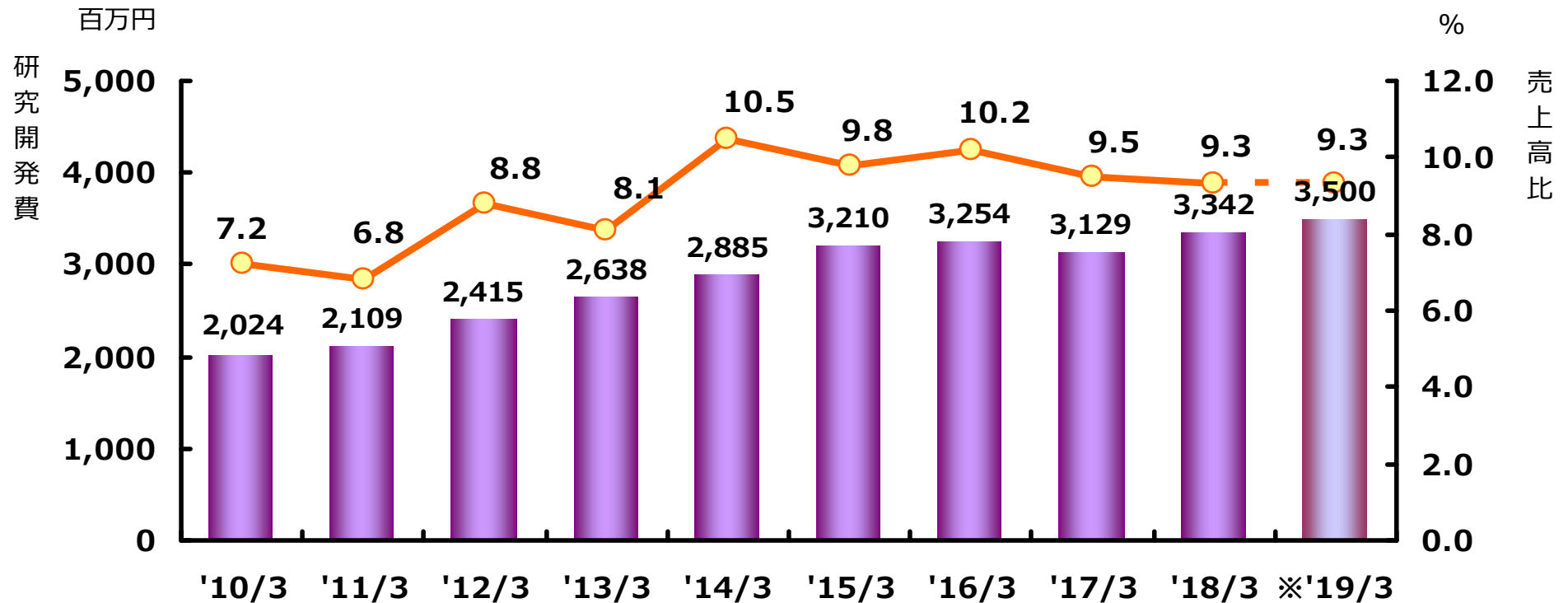
	18年3月期		19年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画 ('18/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	計画比 ('18/5)	下期計画 ('18/5)	下期修正計画 ('18/11)	前年同期比	同年上期比	計画比 ('18/5)
研究開発費	1,619	1,722	1,800	1,679	+3.7%	△2.5%	△6.7%	1,800	1,821	+5.7%	+8.4%	+1.2%



研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

単位：百万円

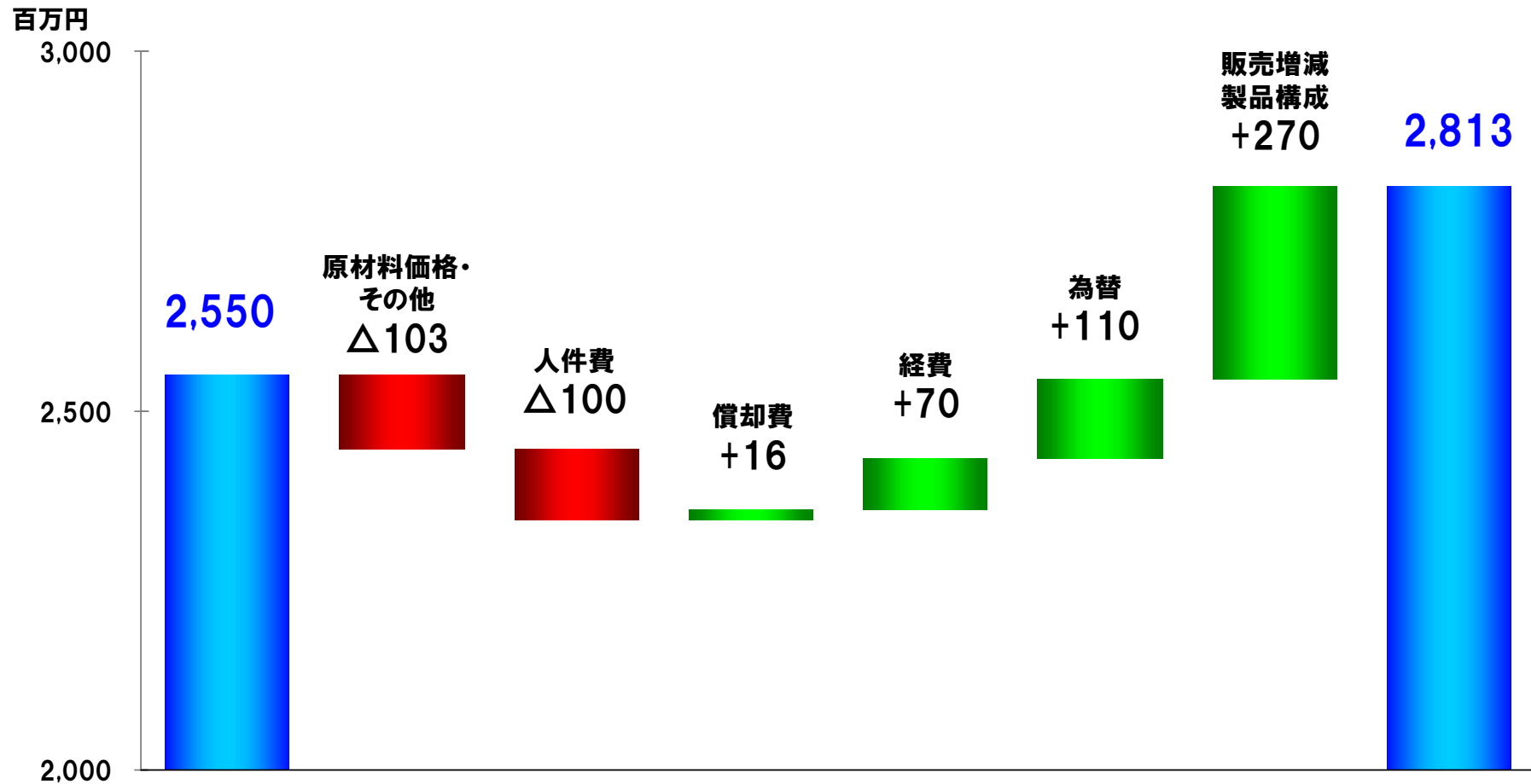
	18年3月期	19年3月期		
	通期実績	通期計画 ('18/5)	通期修正計画 ('18/11)	前期比
研究開発費	3,342	3,600	3,500	+4.6%



損益分析

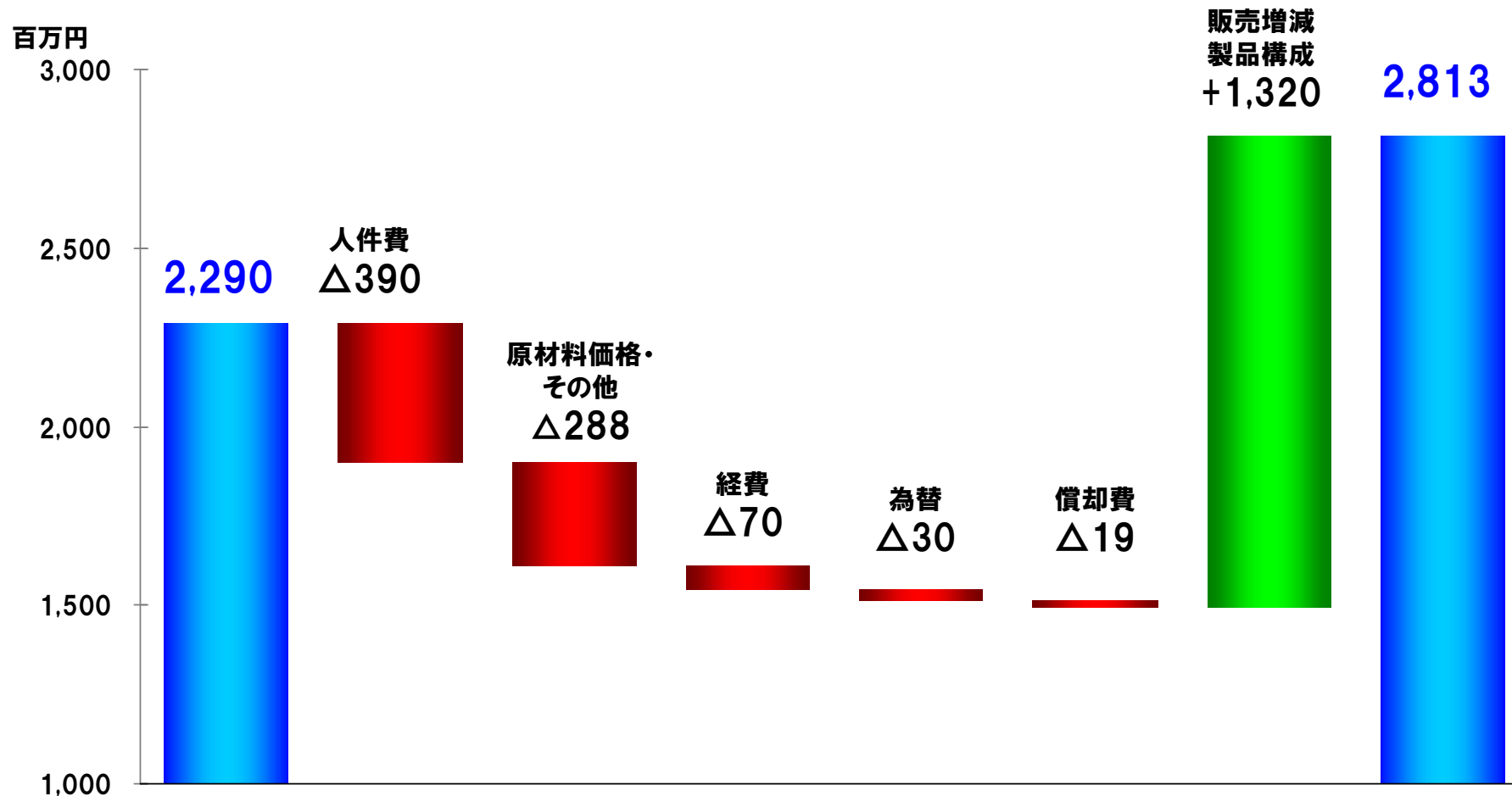
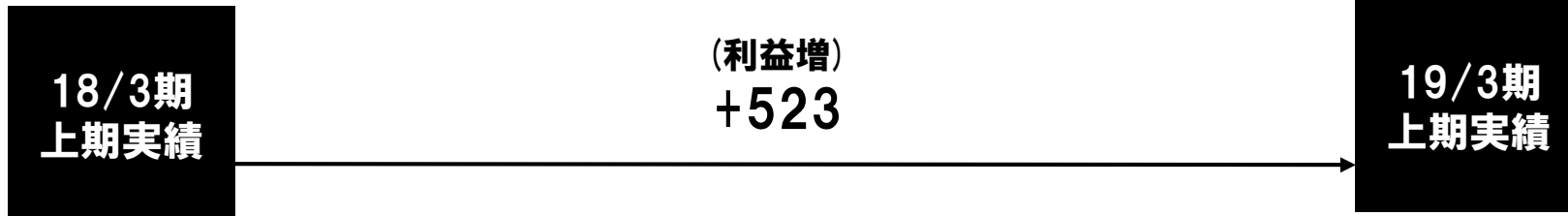
営業利益増減要因

19/3期上期予想→19/3期上期実績



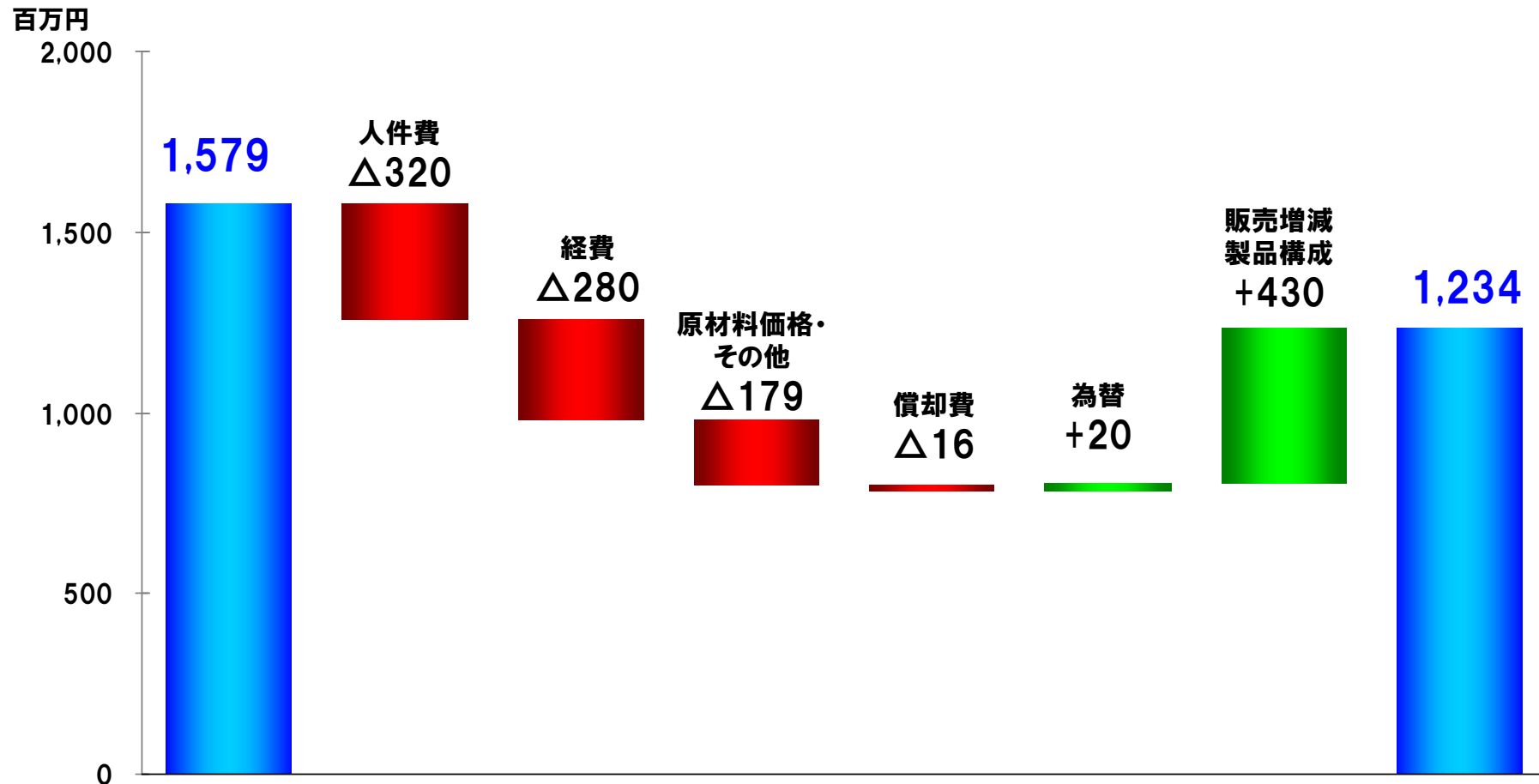
営業利益増減要因

18/3期上期実績→19/3期上期実績



営業利益増減要因

19/3期1Q実績→19/3期2Q実績

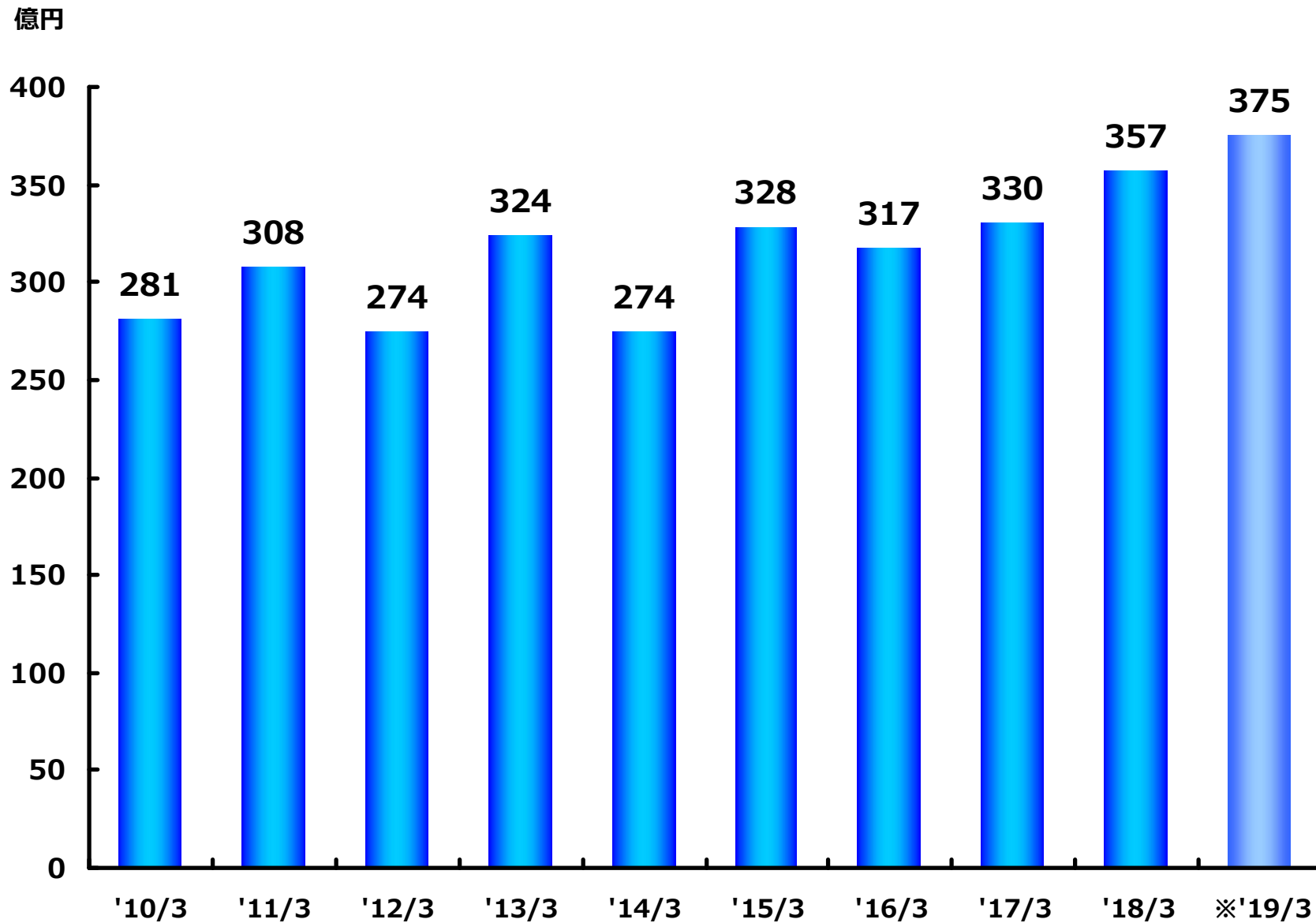


補足説明資料 マーケットデータ等

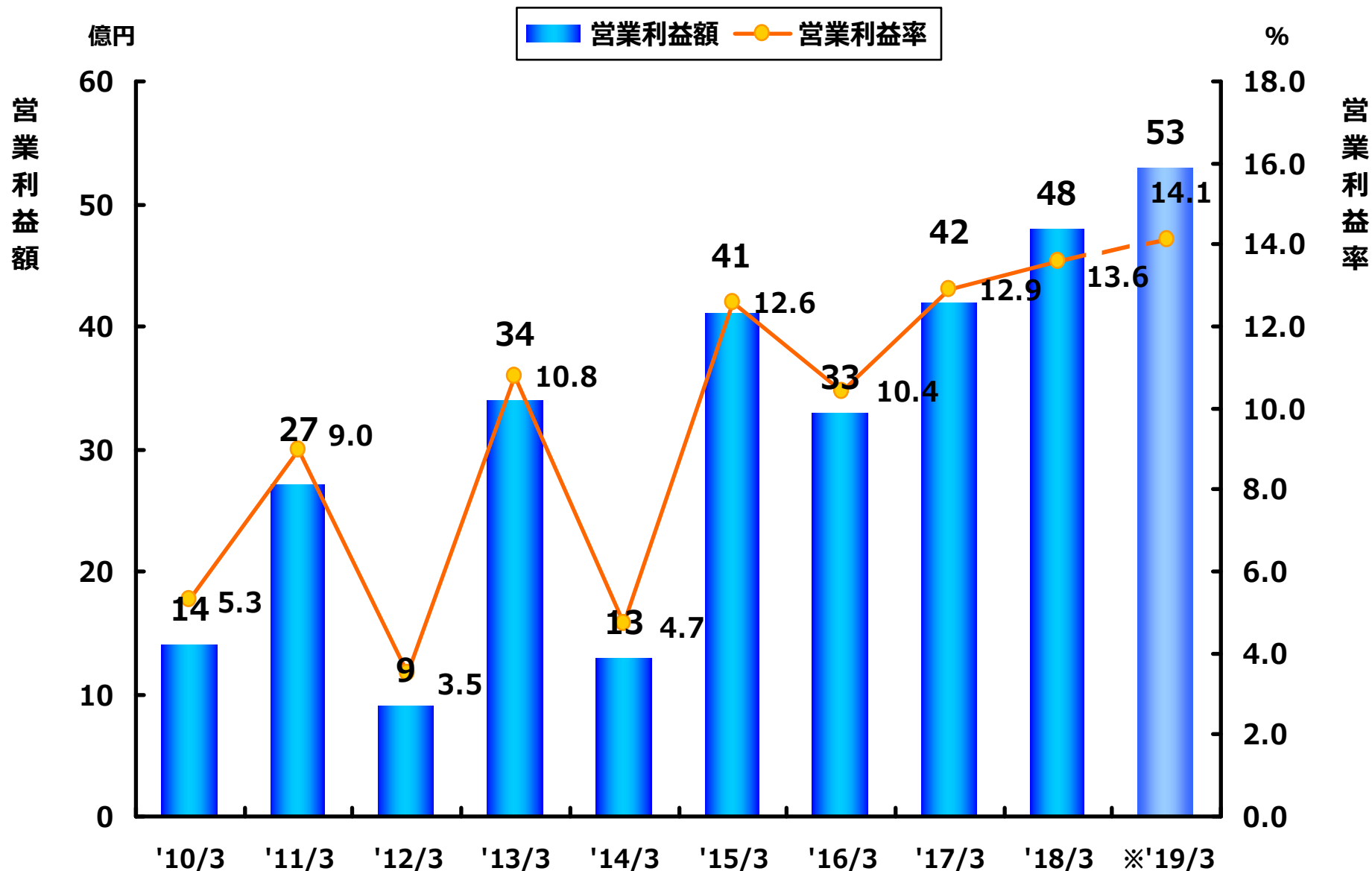
グループ人員 内訳

(人数)	18年3月期 (3月31日現在)		18年3月期 (9月30日現在)			
	正社員	臨時社員※	正社員	臨時社員※	前期末増減	
					正社員	臨時社員※
フジミインコーポレーテッド	580	173	594	174	+14	+1
フジミコーポレーション	111	3	107	4	△4	+1
フジミ台湾	73	0	79	0	+6	—
フジミマイクロテクノロジー	65	8	66	8	+1	—
フジミヨーロッパ	4	2	5	1	+1	△1
フジミ韓国	5	0	5	0	—	—
フジミ深圳	6	0	5	1	△1	+1
合 計	844	186	861	188	+17	+2

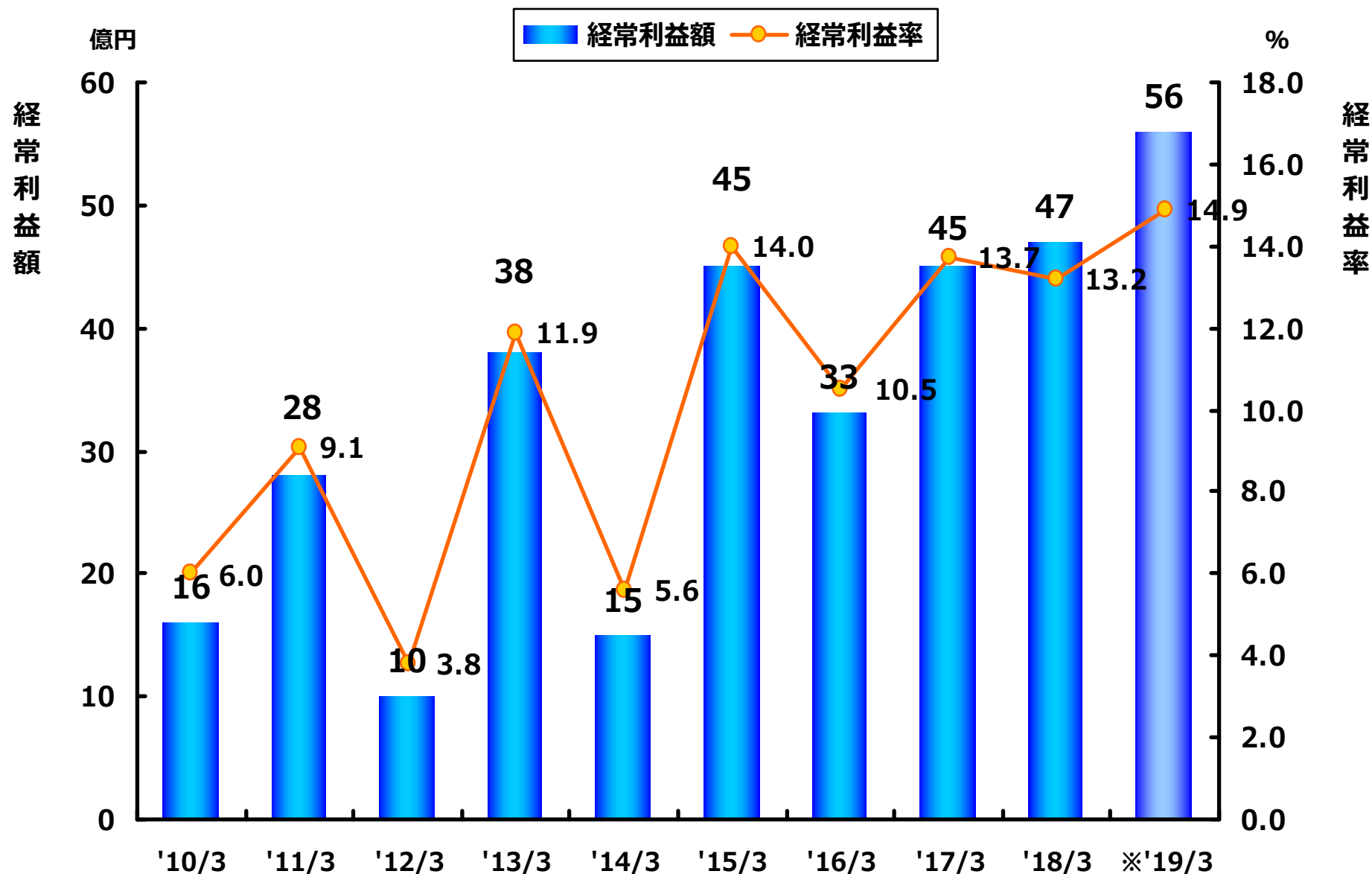
売上高 (通期)



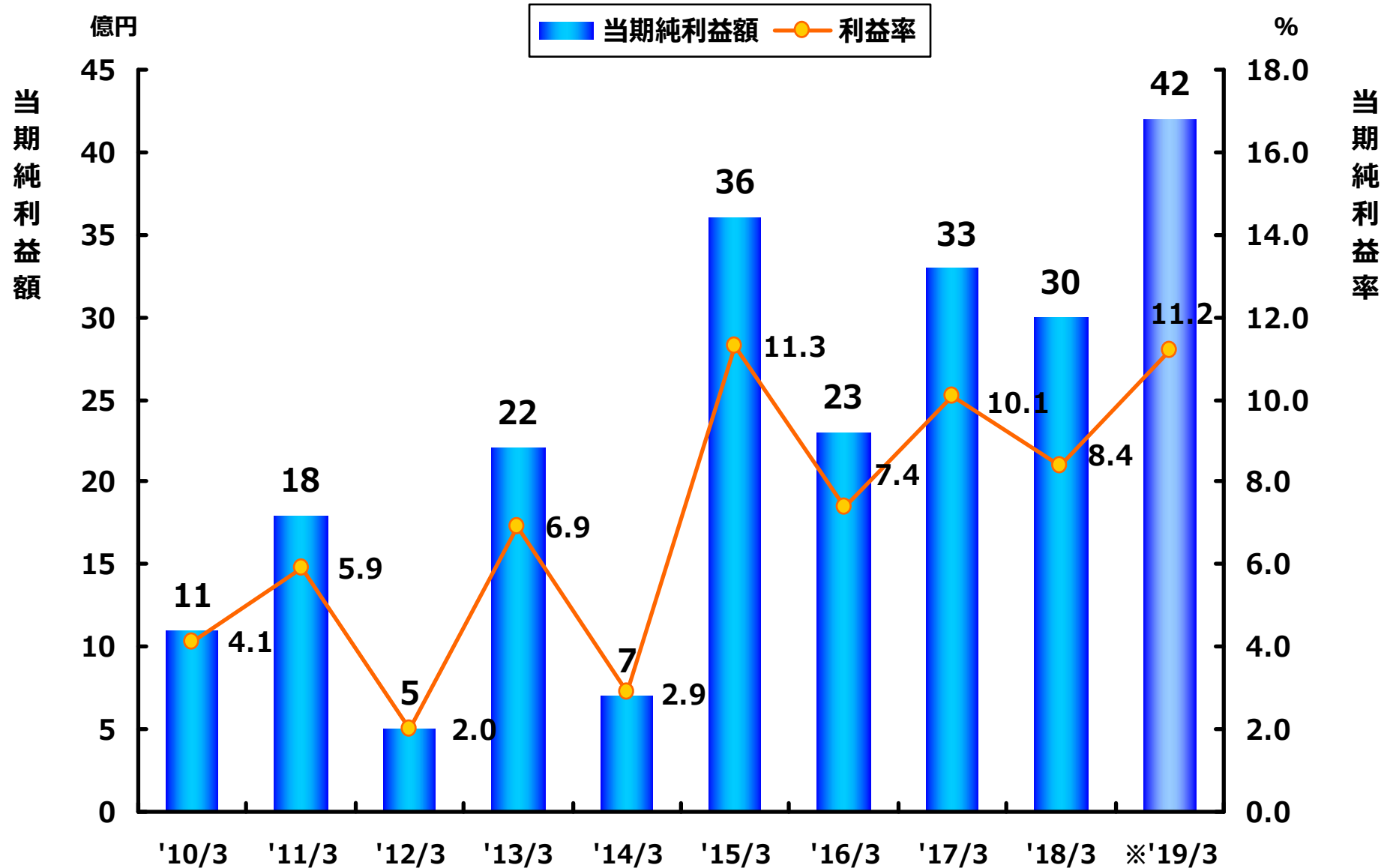
営業利益 (通期)



経常利益 (通期)

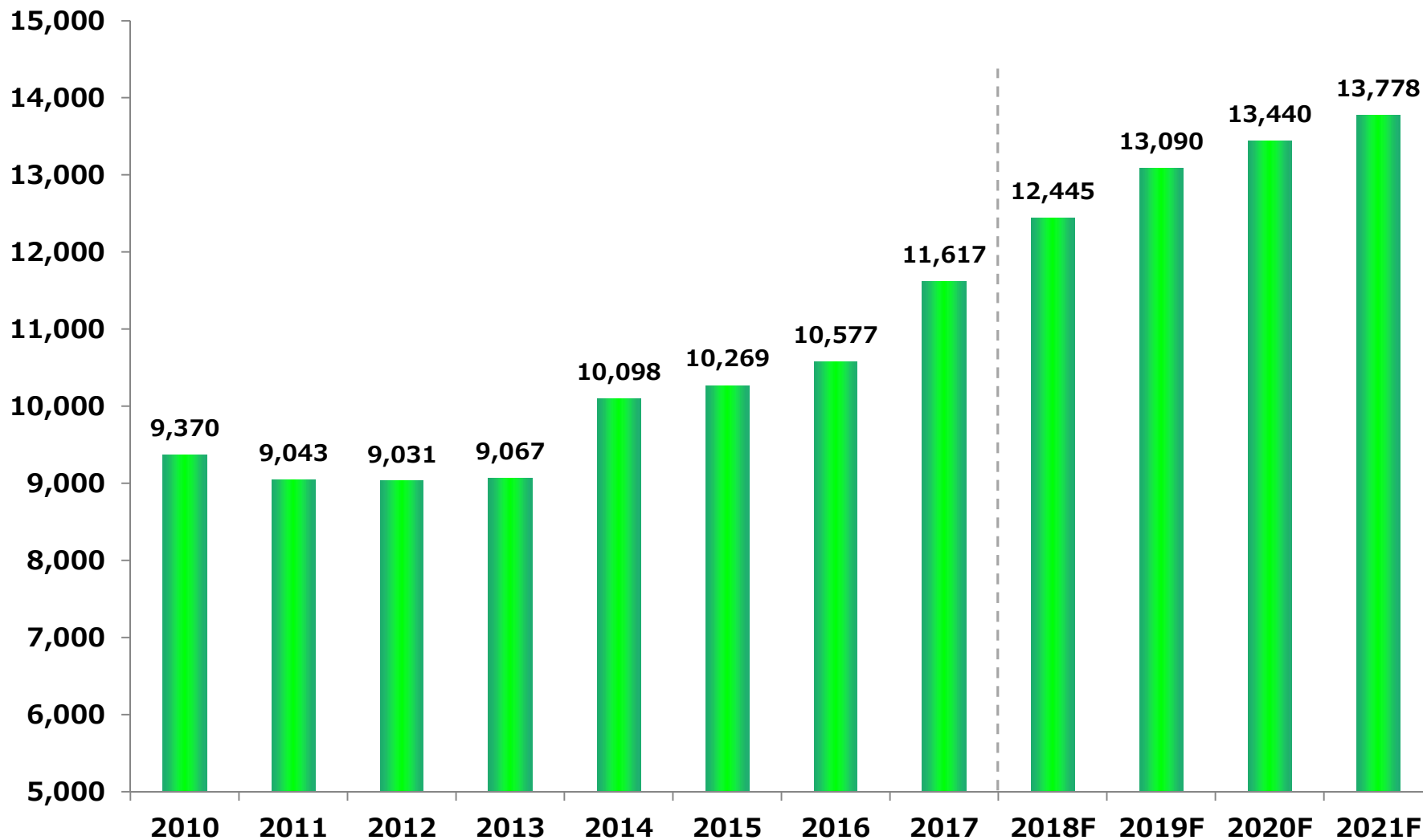


当期純利益 (通期)



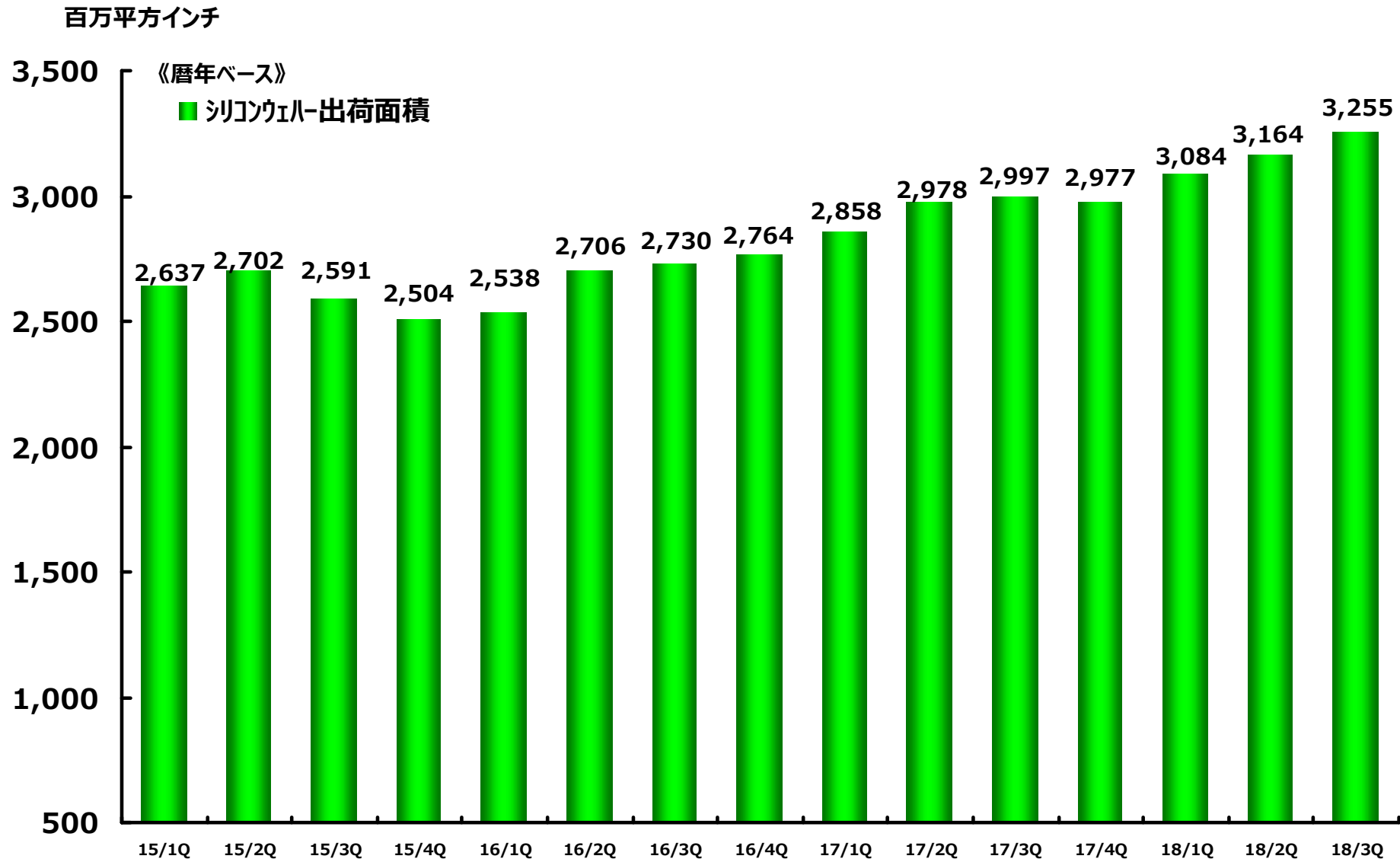
シリコンウェハ需要予測（出荷面積換算 全口径）

百万平方インチ



出典：SEMI（2018/10/17）

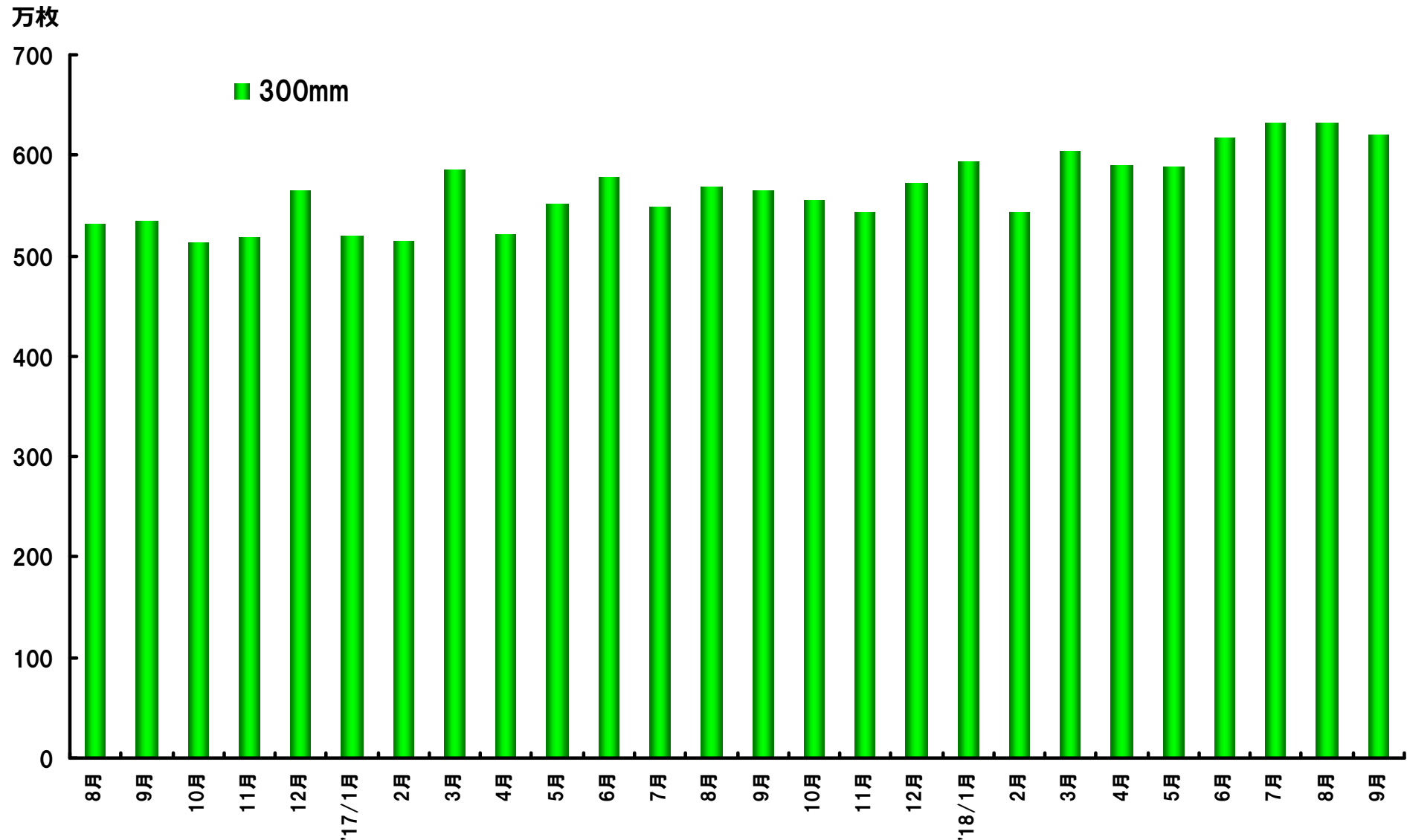
シリコンウェハ－出荷面積 (四半期)



出所：SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International)

300mmシリコンウェハー出荷枚数（月次）

出所： 自社推定



半導体市場規模 (地域別)

(単位：10億ドル)

